

經濟部產業園區管理局 函

地址：81170 高雄市楠梓區加昌路600號
聯絡人：王宜卿
聯絡電話：07-3611212 分機：317
傳真：07-3654713
電子郵件：misery@bip.gov.tw

受文者：經濟部產業園區管理局臺北分局

發文日期：中華民國115年7月2日
發文字號：經園投促字第1150014518號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五 (A13080000G_1150014518_doc1_Attach1.jpg、
A13080000G_1150014518_doc1_Attach2.jpg)

主旨：函轉台中市電腦商業同業公會辦理數位發展部數位產業署
指導之「亞洲晶片安全與CRA國際研討會：下一代可信晶
片安全」研討會資訊，敬請踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、依據台中市電腦商業同業公會115年7月2日中市電總字第
1150000068號函辦理。
- 二、依據財團法人資訊工業策進會與台中市電腦商業同業公會
執行之「晶片安全標準與檢測技術推廣講座」辦理。本計
畫旨在協助國內產業掌握國際資安合規趨勢，並及早因應
未來全球市場對產品安全與晶片安全之要求，特辦理旨揭
研討會。
- 三、本次研討會以「下一代可信晶片安全」為核心，聚焦 PQC
前瞻技術趨勢與歐盟 CRA 全面合規解讀、CRA 全球資安戰
略與產業實踐，以及全球多重法規下之晶片資安策略等重
點議題，邀請國內外晶片安全、產品合規、資安驗證及國
際標準領域專家進行專題分享，協助企業掌握國際法規脈

經濟部產業園區管理局臺北分局



動與實務因應方向。因名額有限，敬請貴單位協助宣導，提醒所屬企業或會員及早派員報名，以免向隅。活動資訊如下：

(一)亞洲晶片安全與 CRA 國際研討會：下一代可信晶片安全

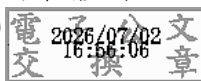
- 1、時間：115年7月30日（四）13:30 ~ 16:40。
- 2、活動地點：政大公企中心 A1034 階梯型會議教室（臺北市大安區金華街187號 A棟10樓）。
- 3、核心內容：PQC前瞻技術趨勢與歐盟CRA全面合規解讀、CRA 全球資安戰略與產業實踐、全球多重法規下的晶片資安策略。
- 4、合適對象：產品合規與資安管理人員、晶片設計與系統開發工程師、IC 設計業、ODM／OEM、IPC、工控、物聯網、車用電子、資通訊產品製造商，以及關注CRA合規、晶片安全、產品資安與國際標準接軌之相關從業人員參與。
- 5、活動費用：免費參加，名額有限，採線上報名，主辦單位保留審核權利。

四、敬請貴單位惠予公告周知，並鼓勵相關部門主管及業務承辦人員踴躍報名參加，共同掌握晶片安全與國際資安法規發展趨勢。即日起請至台中市電腦商業同業公會指定線上報名系統（<https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=3358>）或掃描附件宣傳海報之QR Code辦理報名。如有活動相關疑問，請聯絡承辦人員許先生（電話：04-22421717#235，cody@tcca.org.tw）。

五、檢附本次活動DM乙式。

正本：楠梓園區區內事業電子公布欄、高雄軟體園區區內事業電子公布欄、本局各分局

副本：本局高雄軟體園區辦公室(含附件)



裝

訂



線